



DISCO

Kiru · Kezuru · Migaku Technologies

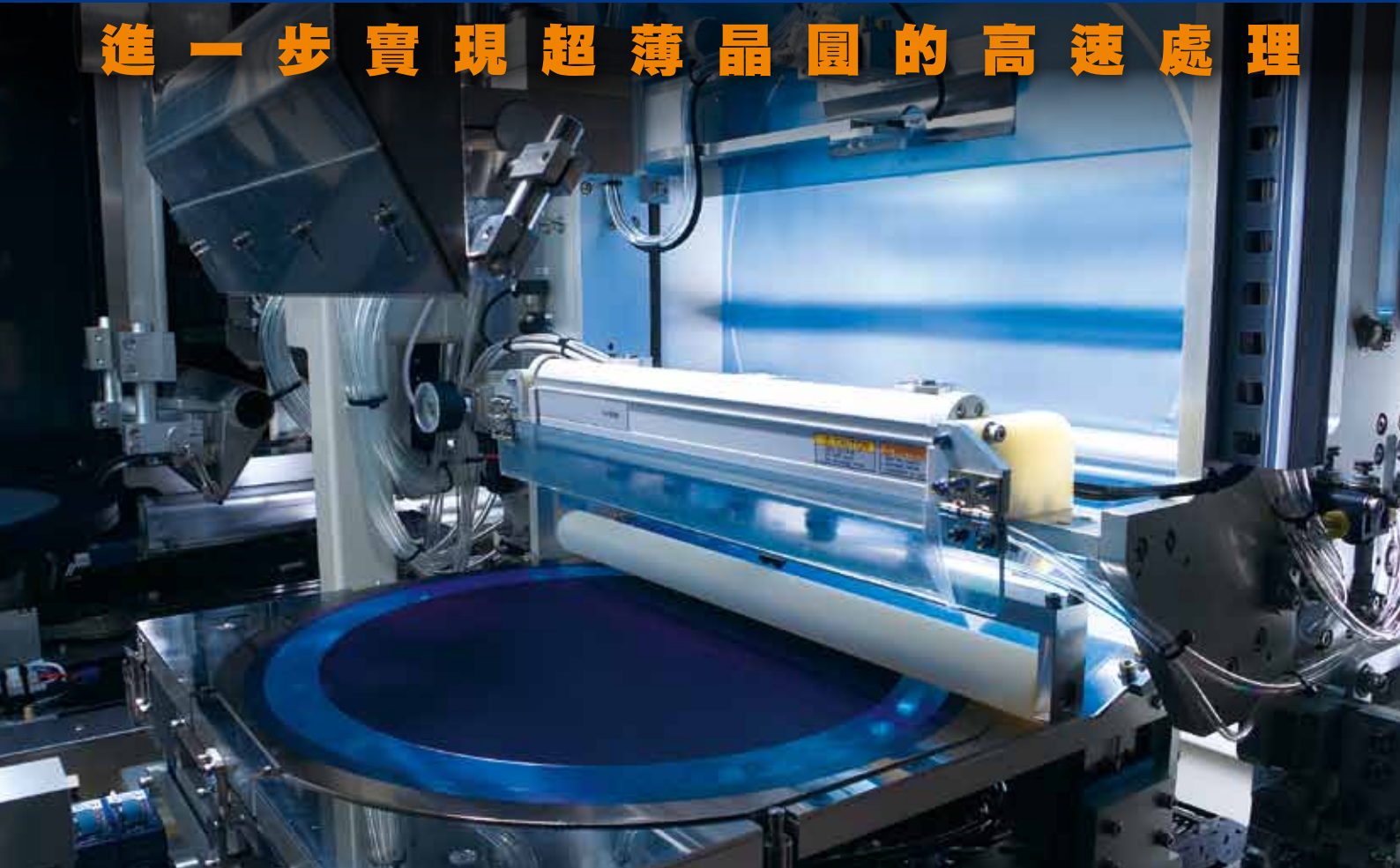


全自動多功能晶圓貼膜機

DFM2800

Fully Automatic Multifunction Wafer Mounter

進一步實現超薄晶圓的高速處理



實現高良率的薄型化技術

DFM2800是與背面研磨機組成聯機系統的特殊晶圓貼膜機，用於加工 $\phi 300$ mm超薄晶圓。從在經過DGP8761薄化處理後的晶圓上黏貼切割膠膜，再加上框架，到剝除表面保護膠膜為止，整合製程一貫化，安全可靠地執行。本設備還適用於新一代SiP (System in Package) 製造所不可或缺的切割膠膜一體化的DAF (Die Attach Film) 粘貼。

適用於25 μm 以下厚度的超薄晶圓加工

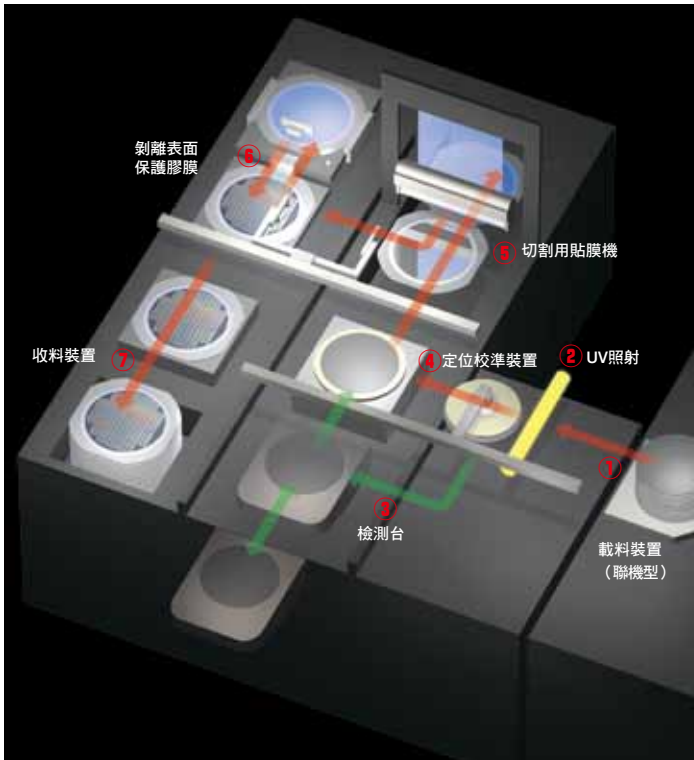
為了滿足 $\phi 300$ mm、25 μm 以下厚度的薄型化要求，本設備將內部晶圓搬運次數降低為舊機型的1/5，並盡可能減少超薄晶圓發生破損的風險。另外還在各搬運墊/台上配置了清洗裝置，防止微粒混入使使晶圓破損。



DFM2800

DGP8761



**DFM2800 技術規格**

電源	輸入電源	三相AC200 V±10% 50/60 Hz 上述以外需配置變壓器		
	耗電量	kW	4	
	最大耗電量	kVA	17	
壓縮空氣裝置	壓力	MPa	0.6 ~ 0.8	
	壓力變化範圍	MPa	0.03 以下	
	流量	L/min	800 以上(暫定)	
真空裝置	壓力	KPa	-80 以上	
	流量	L/min	200	
排氣管	設備主機單元	排風量	m ³ /min	0.4 以上(參考值)
		靜壓	KPa	0.04 以上(參考值)
	UV照射部位	排風量	m ³ /min	2.7 ~ 5.1 (參考值)
		靜壓	KPa	0.27 ~ 0.51 (參考值)
	排風機構	排風量	m ³ /min	8.0 以上(參考值)
		靜壓	KPa	0.06 以上(參考值)
其他規格	設備尺寸(W × D × H)	mm	2,150 x 2,643 x 1,800	
	設備重量	kg	3,100	

■使用條件

- 請使用大氣壓露點在-15℃以下，殘餘油分為0.1 ppm，過濾度在0.01 μm/99.5%以上的清潔壓縮空氣。
- 請將放置機械設備的房間室溫設定在20℃~25℃之間，並將波動範圍控制在±1℃以內。
- 其他，請避免設備受到撞擊及外界的有感振動。另外，請不要將設備安裝在鼓風機、通風口、產生高溫的裝置及產生油霧的裝置附近。

*為了改進設備，本公司可能在預先不通知用戶的情況下，就對本規格實施變更，因此請仔細確認規格後發出訂單。

*壓力全部使用壓力錶指示壓力值表示。

*關於本設備的應用技術等諮詢，請與本公司銷售部門聯絡。

■工作流程系統

- 接受從背面研磨機傳送過來的工作物 → ②對表面保護膠膜進行UV(紫外線)照射(在使用UV膠膜時) → ③將工作物搬運到檢測台上(任意選項) → ④藉由影像處理實施定位校準作業 → ⑤使用切割膠膜或者2 in 1 DAF膠膜，將工作物安裝到切割框架上 → ⑥剝離表面保護膠膜 → ⑦放入切割框架儲存盒

高生產效率

合理配置各搬運機構，連續工作時最大生產效率增加約50%※，有助於提高生產性。(與DFM2700相比較)

※實際生產效率取決於晶圓貼膜技術時間及表面保護膠膜的剝離時間。

豐富的特殊選配，可滿足各種需求

- 機械手臂/獨立晶圓載入機，使本設備可作為獨立設備運行
- 在設備內部對切割膠膜進行預切割的預切割裝置
- 表面保護膠膜的粘著式膠膜剝離裝置
- 晶圓貼膜後用於進行條碼管理的晶圓表面ID識別裝置(條碼辨識系統)

操作簡便

本設備繼承了DFM2700的操作方式，並進一步擴大了畫面尺寸，提高了畫面品質，使用更容易，操作更簡單。另外，在與DGP8761組成的聯機系統中，可以由DGP8761選擇DFM2800的加工程式，進行開始/結束等綜合管理，進一步提高了使用便利性。